

4 小面積 LGA タイプコネクタの開発

Development of Compact LGA Connector

榎本 敏男 Toshio Masumoto コネクタ事業部 技術一部

キーワード：コネクタ、LGA

要旨

DVC、DSC、携帯電話等の小型・携帯電子機器のさらなる小型化、高密度実装化が進むなかで、コネクタへの低背化、小面積化の要求は強くなっております。今回この要求を満たすべく、リードレス、LGAタイプで、従来の0.5mmピッチ品と比べ、半分以下の実装面積となるコネクタ(WA3シリーズ)を開発することができました。コネクタは0.4mmピッチ相当の実装面積ですが、接触部、実装部共に0.8mmピッチ千鳥配列で、自動実装対応可能であります。また半田付け強度は従来のリードタイプと同等の強度を確保することができました。

SUMMARY

Progress toward increasing miniaturization and higher density mounting for DVCs, DSCs, mobile phones, and other devices has heightened the need for low-profile, small-footprint connectors. To meet this need, we developed a leadless, LGA type connector (WA3 Series) that has less than half the footprint of existing 0.5mm pitch products. This connector has a footprint equivalent to 0.4mm pitch, but a staggered 0.8mm pitch layout for both the connection and mounting sections and can be auto-mounted. Moreover, the soldering strength is the same as that for existing lead-type connectors.